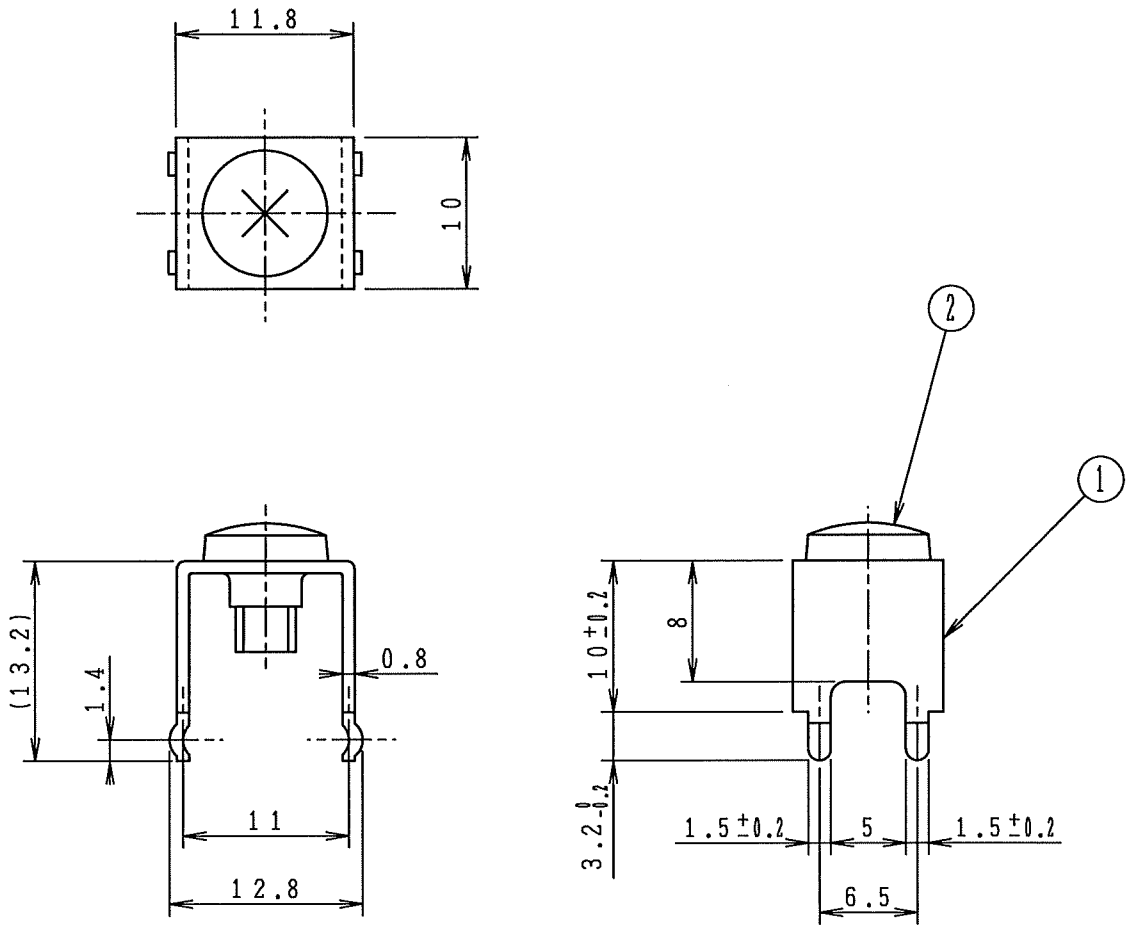
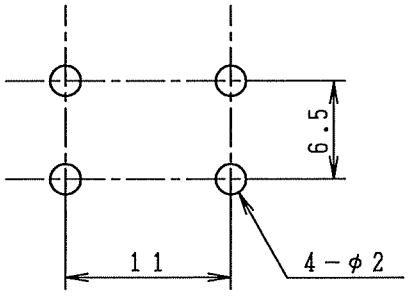
部番	名　称	材　質	寸　法	処　理	備　考
1	基板端子	△4 黄銅	t=0.8	△2△3△4 ｽｽﾞﾒｯｷ	
2	結線ビス	△4 黄銅	M4×6L	△4 ﾆｯｹﾙﾒｯｷ	バインド



基板加工例



プリント基板厚t=1.4～2.0

△3△4
※品名ラベルに「RoHS Compliance」と表示すること。

△4 注文方法：型名

改定 記号	日付	内　容	指示なき公差	定格	図番	設計	
△4 6	'09.12.4	ﾒｯｷ表示方法・備考訂正 注文方法追記　福満	±0.3	AC V 20 A	△2 105694-4	製図	池田 '04.7.12
△3 2	'05.6.28	メッキ厚訂正　池田 鉛ﾌﾘｰ表追記		絶縁抵抗 DC V MΩ以上	図名 F4063CS	検図	下松 '04.7.13
△2 2	'04.7.12	図面書換え 鉛ﾌﾘｰに変更　池田		耐電圧 AC V 1分間異常なし	三角法 単位 mm 尺度 2/1	承認	下松 '05.6.28
					FJC フジコン株式会社		